

2022.5.6 ニュースリリース

米大手半導体メーカーより先端半導体パッケージ用 『はんだボールマウンタシステム』受注のお知らせ

AIメカテック株式会社(本社:茨城県龍ケ崎市向陽台、社長:阿部 猪佐雄)は、米国大手半導体メーカーよりはんだボールマウンタ設備をシステム一括ラインとして受注致しましたので以下の通りご報告申し上げます。

コンピューターがPCからモバイルデバイスへと進化しAI時代に突入した今、半導体パッケージングが担う役割は劇的に変化しております。大容量、高速通信、低消費電力などのニーズを背景に、半導体メーカー各社は微細化プロセスの技術開発に加え、マルチチップ及び3Dスタッキング含む高性能パッケージング技術の開発に注力しております。このような背景のもと当社は、ボールマウント技術にフラットパネル用量産設備で培ってきたシステムインテグレーション技術を盛り込んだ新型機Gシリーズをご提案、高い評価をいただき受注に至りました。

高性能パッケージング技術が要求される先端半導体パッケージでは高品質・高良品率へのニーズが高く、歩留り率向上を実現できる当社設備の採用が検討されおります。今後の更なる半導体関連事業拡大へ寄与していくと期待しております。

当社は、今後も製造プロセスのイノベーションを通してより便利で豊かな生活スタイルの向上により社会に貢献できる企業を目指して参ります。

お問い合わせ

AIメカテック株式会社

営業部 TEL:0297-62-9119

<https://www.ai-mech.com/>